

《电子产品工艺》

图书基本信息

书名：《电子产品工艺》

13位ISBN编号：9787121054136

10位ISBN编号：7121054132

出版时间：2008-2

出版社：电子工业

作者：龙立钦，范泽良主

页数：199

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《电子产品工艺》

内容概要

《中等职业学校教学用书(电子技术专业)·电子产品工艺(第2版)》是电子类中等专业学校专业课教材，内容包括电子材料，电子元器件，印制电路板设计与制作，焊接工艺，电子产品装配工艺，表面组装技术，电子产品调试工艺等。并利用x——118型超外差式收音机进行装调实例介绍。

《中等职业学校教学用书(电子技术专业)·电子产品工艺(第2版)》突出理论联系实际，着重介绍新知识、新技术、新工艺和新方法，强调内容实用性、针对性，注重培养学生的实际应用和实际操作能力，内容叙述力求深入浅出、图文并茂、通俗易懂，内容编排力求简洁明快、形式新颖、目标明确。

《电子产品工艺》

书籍目录

第1章 电子材料	1.1 导电材料	1.1.1 导电材料的特性	1.1.2 高电导材料	1.1.3 高电阻材料	1.1.4 导线	1.1.5 焊接材料	1.1.6 敷铜板	1.2 绝缘材料	1.2.1 绝缘材料的特性	1.2.2 有机绝缘材料	1.2.3 无机绝缘材料	1.3 磁性材料	1.3.1 磁性材料的特性	1.3.2 软磁材料	1.3.3 硬磁材料	本章小结	习题1							
第2章 电子元器件	2.1 电阻器	2.1.1 固定电阻器	2.1.2 可变电阻器	2.1.3 敏感电阻器	2.2 电容器	2.2.1 固定电容器	2.2.2 可变电容器	2.3 电感器	2.3.1 电感线圈	2.3.2 变压器	2.4 半导体器件	2.4.1 半导体器件的命名方法	2.4.2 半导体二极管	2.4.3 半导体三极管	2.4.4 集成电路	2.5 表面组装元器件	2.5.1 表面组装元器件的特点	2.5.2 无源元件(SMC)	2.5.3 有源器件(SMD)	2.6 其他常用器件	2.6.1 压电器件	2.6.2 电声器件	本章小结	习题2
第3章 印制电路板设计与制作	3.1 印制电路板(PCB)设计基础	3.1.1 印制电路的基本概念	3.1.2 印制焊盘	3.1.3 印制导线	3.2 印制电路的设计	3.2.1 PCB设计流程	3.2.2 PCB设计应遵循的原则	3.2.3 计算机辅助设计介绍	3.3 印制电路板的制作工艺	3.3.1 印制电路板原版底图的制作	3.3.2 印制电路板的印制	3.3.3 印制电路板的蚀刻与加工	3.3.4 印制电路板质量检验	3.4 印制电路板的手工制作	3.4.1 涂漆法	3.4.2 贴图法	3.4.3 刀刻法	3.4.4 感光法	3.4.5 热转印法	本章小结	习题3	实训项目：印制电路板的手工制作		
第4章 焊接技术	4.1 焊接基础知识	4.1.1 焊接的分类及特点	4.1.2 焊接机理	4.1.3 锡焊的必要条件	4.2 手工焊接技术	4.2.1 焊接工具	4.2.2 手工焊接方法	4.2.3 无锡焊接方法	4.3 自动焊接技术.....	第5章 装配准备工艺	第6章 电子产品装配工艺	第7章 表面组装技术(SMT)	第8章 电子产品调试工艺	第9章 X-118型超外差式收音机装调实例	参考文献									

精彩短评

1、收到了快递送来的书，对快递的服务工作感到满意。我是当当的老顾客，对当当的服务工作很满意。这本书的内容正是我所需要的。书的文字流畅，叙述清晰而扼要，其内容可操作性强，知识面、知识点的覆盖合理。能看出作者所具有的专业水准以及认真的写作态度。这本书的内容是扎扎实实的传授知识和技术，而不是那些“复制”“粘贴”而来的货色。给予较高评价。刚才简单翻阅了一遍，感到书中的插图相对较少且图幅偏小；插图在画技方面还需要努力。现代的阅读方式，“读图”占有重要比重。工作繁忙，事情千头万绪，哪有时间把一本书从头至尾、一字不落的读完？人们大多以看图为主，不清楚的地方再细阅文字。对技术书籍而言，文字在一定程度上就相当于插图的“图片说明”。因此，希望这本书将来如有机会再版时，作者能够对插图进一步进行加工，使之对读者具有更深的吸引力和感召力。当然，这同时也是对书的整体品质的一个提升。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com